

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	胡译
电话	0512-67730001	0512-67730001
传真	0512-67730808	0512-67730808
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

- 1.6 2015 年度公司利润分配预案为：以公司总股本 226,696,955 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 24,936,665.05 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

二 报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者

与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片(MEMS)、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等，该等产品广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机、游戏机）、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。

2、公司经营模式

公司为专业的集成电路封测服务提供商，业务模式为客户提供晶圆或芯片委托公司封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，由生产部门组织芯片封装、测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。公司生产所需原辅材料通过采购部直接向国内外供应商采购，具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。

3、行业情况说明

公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。集成电路产业链是半导体产业的典型代表，因为其技术的复杂性，产业机构向高度专业化转化，可细分为 IC 设计业、芯片制造业及 IC 封装测试业三个子产业群。由于具备成本和地缘优势，我国集成电路封装测试产业获得了快速发展，随着国外半导体公司的产业转移与我国半导体企业的兼并浪潮，目前我国已成为全球集成电路的主要封装基地之一，封装测试业也成为我国半导体产业的发展主体，在市场、技术、产业链等全面向国际先进水平靠拢，2015 年我国集成电路封装测试销售收入规模为 1,384 亿元，占我国集成电路产业总销售收入比重为 38.34%。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,998,451,514.31	2,048,488,734.82	-2.44	1,070,182,076.92
营业收入	575,718,355.28	615,810,322.31	-6.51	450,433,205.85
归属于上市公司股东的净利润	113,275,303.59	196,310,877.99	-42.30	153,732,160.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,364,485.88	167,551,525.92	-53.83	145,032,038.73
归属于上市公司股东的净资产	1,647,805,449.22	1,572,291,922.29	4.80	750,777,560.89
经营活动产生的现金流量净额	206,656,321.74	239,583,810.31	-13.74	203,819,606.97
期末总股本	226,696,955.00	226,696,955.00	0.00	189,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.50	0.88	-43.18	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.88	-43.18	0.81
加权平均净资产收益率（%）	6.95	13.69	减少6.74个百分点	20.94

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	170,569,774.79	133,763,632.82	147,675,204.17	123,709,743.50
归属于上市公司股东的净利润	49,400,777.36	19,644,019.89	26,609,133.14	17,621,373.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,871,535.95	13,055,654.87	16,573,798.23	6,863,496.83
经营活动产生的现金流量净额	62,765,124.66	16,572,562.05	51,769,966.42	75,548,668.61

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		18,770					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		16,678					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	0	57,160,964	25.21	57,160,964	质押	48,600,000	境外 法人
中新苏州工业园 区创业投资有限 公司	0	55,048,276	24.28	55,048,276	质押	15,700,000	国有 法人
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	0	30,261,687	13.35	0	无		境外 法人
英菲尼迪—中新 创业投资企业	-6,724,819	6,724,819	2.97	6,724,819	无		其他
中国证券金融股 份有限公司	4,929,784	4,929,784	2.17	0	未知		未知

苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	0	3,826,731	1.69	3,826,731	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,809,688	3,809,688	1.68	0	未知		未知
GILLAD GAL-OR	0	3,530,530	1.56	0	无		境外自然人
苏州豪正企业管理咨询有限公司	0	3,236,688	1.43	3,236,688	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	2,829,300	2,829,300	1.25	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



1、公司不存在控股股东情况的特别说明

截至报告期末，公司股权结构较为分散，第一大股东 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为 25.21%和 24.28%，无任何股东直接持股比例高于 50%，且股东间不存在一致行动的情形，因此公司无控股股东。

2、公司不存在实际控制人情况的特别说明

由于公司的股权结构、董事会构成特点，无任何单一股东对公司的经营方针及重大事项的决策能够决定和作出实质影响，并且股东之间不存在一致行动情形，因此，公司无实际控制人。

(1) 公司董事会构成情况。公司董事会由 9 名董事组成，Engineering and IP Advanced

Technologies Ltd. 委派一名、中新苏州工业园区创业投资有限公司委派两名，Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limited 委派一名，还有两名共同委派，其余三名独立董事，各股东在董事会席位上的分配比较均衡。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无单一股东对董事会有实质影响，单一股东对公司董事会均不构成实际控制。

(2) 公司股权情况。根据《公司法》及公司章程的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。截至报告期末，公司股权结构较为分散，第一大股东 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为 25.21% 和 24.28%，无任何股东直接持股比例高于 50%。虽然中新苏州工业园区创业投资有限公司及其全资子公司华圆管理咨询(香港)有限公司持有 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 28.28% 的股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司持有英菲尼迪-中新创业投资企业 49.50% 股权，同时持有英菲尼迪-中新创业投资企业的必备投资者华亿创业投资管理(苏州)有限公司 50% 的股权。但中新苏州工业园区创业投资有限公司对 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、英菲尼迪-中新创业投资企业均无实际控制权，因此，中新苏州工业园区创业投资有限公司及其子公司、控股股东在公司其他股东中持股不会影响中新苏州工业园区创业投资有限公司作为公司股东的实际表决权；公司各股东均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；其各自亦与其他公司股东之间不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能支配的公司股份表决权数量的行为或者事实。因此，单一股东对公司的普通及重大决议均不产生实质影响，公司无控股股东，无实际控制人。

5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

2015 年全球半导体产业周期性调整，市场整体下滑，我国集成电路产业在产业政策、并购整合、外资加大投资等多因素推动下虽然保持较快增长态势，但增速也开始出现下滑，其中封装测试业增速由 2014 年的 14.3% 下降为 10.2%，增速下滑较快，行业面临较大的经营压力。

在此背景下，公司秉承“专注，执着，务实，创新，共赢”的核心价值理念，持续专注于传感器领域的封装业务，在技术上以市场和客户需求为导向，坚持技术持续研发与创新，注重知识产权体系的全球布局；深耕于技术工艺升级与优化，以适应市场发展需求和新领域、新产品的需求；进一步提升 12 英寸 3D TSV 封装技术的工艺能力与生产规模水平，保持公司在该领域的技术领先优势与市场规模优势；积极发展高阶产品扇外型封装技术、系统级封装技术、汽车电子产

品封装技术等多种应用领域的技术开发与认证，以顺应产业的发展步伐与新的市场机遇。

在市场与业务上受全球智能手机增速放缓，行业整体需求疲软，去库存压力较大的影响，公司的业务与市场竞争更趋激烈，整体销售额与盈利水平较 2014 年下滑。面对日益激烈的市场竞争，公司努力着手于新产品与新应用市场的拓展，在加强 CIS 领域市场拓展与客户开发的同时，不断开发新的产品应用市场，并在安防监控、生物身份识别模组等领域取得了较快发展，在汽车电子、虚拟现实等领域进行了积极有效布局。同时，公司持续加强客户拓展，提升公司核心客户群体，实现并保持与全球主要设计公司的战略合作，将为公司的后续发展奠定良好的产业与市场地位。

在管理运营上不断加强内部管理与资源整合，持续推进内部管理模式改革与管理水平提升，有效提升生产效率，降低管理成本。积极整合收购的智瑞达科技相关资产、业务技术与人才资源，并与公司现有的技术和人才队伍进行有效融合，有效提升公司技术的全面性与延伸性，并使公司具备封装—测试—模组的全方案服务能力，为公司的未来发展奠定新的业务基础与业务模式。启动并基本完成了苏春工业坊产区的搬迁工作，有效整合了厂区资源，并将部分老旧资产进行了集中处置，有效提升公司生产效率，节约运营与管理成本，提高资产的整体运营效率与水平。

报告期内公司实现销售收入 57,571.83 万元，同比下降 6.51%，实现营业利润 10,715.72 万元，同比下降 45.2%，实现净利润 11,327.53 万元，同比下降 42.3%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	直接
1	晶方半导体科技（北美）有限公司	晶方北美	100.00	—

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2016 年 4 月 11 日